[redacted]

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
CC: de Staatssecretaris van Economische Zaken - Digitale Economie en Soevereiniteit

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie

Auteur
[redacted]

TER BESLISSING
Datum aangemaakt
19 juni 2026

Kenmerk
DGBI-I / 107064712

RT-0000147662

Kopie aan

Bijlage(n)
1

nota
TER BESLISSING

BNC Fiche Chips Act 2.0

Parafenroute

[redacted]

Aanleiding

Op 3 juni 2026 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een Europese verordening ter versterking van de Europese halfgeleiderindustrie (Chips Act 2.0; CAII). De CAII is een herziening van de Chips Act uit 2023 en onderdeel van het Tech Sovereignty Package (TSP). Door EZK is een BNC-fiche voor het CAII wetsvoorstel opgesteld.

Geadviseerd besluit

- U wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van het CAII BNC-fiche.
- U wordt gevraagd akkoord te gaan met het verzenden van het BNC-fiche aan de Kamer na afstemming in de CoCo van 7 juli en de MR van 10 juli.

Kernpunten

- Het TSP, bestaande uit een overkoepelende mededeling over technologische soevereiniteit inclusief een Open Source Strategy, CAII, de Cloud and AI Development Act (CADA), en een Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in Energy, wordt beschouwd als hét antwoord van de Commissie op het maatschappelijke debat over technologische soevereiniteit in de digitale waardeketen van de EU.
- De versnelde herziening van de Chips Act is mede te danken aan het Nederlandse initiatief voor de Semicon Coalition, die opriep dat de hele waardenketen voor halfgeleiders moet worden versterkt in de EU, langs de principes van onmisbaarheid (indispensability), weerbaarheid (resilience) en welvaart (prosperity).
- Met de CAII wil de Commissie het concurrentievermogen en de crisisparaatheid van de Europese halfgeleiderindustrie versterken, en introduceert nieuwe instrumenten die bijdragen aan deze doelstellingen.

- Ten opzichte van de eerste Chips Act verschuift het wetsvoorstel van een aanbodgerichte aanpak (productie en innovatie), naar een combinatie met vraaggerichte maatregelen (afname).
- Het fiche stelt dat het kabinet de doelstelling van de CAII verwelkomt om de Europese halfgeleiderindustrie te versterken, afhankelijkheden af te bouwen, en crisisparaatheid te vergroten. Deze sluit in grote lijnen aan bij de Nederlandse non-paper[1] inzake het TSP, de Semicon Coalition declaration en de inzet vanuit Nederland richting de publieke consultatie. Dit geldt met name voor de meer vraaggestuurde aanpak, de grotere focus op industrialisatie en op mitigerende maatregelen voor kritieke en risicogevoelige sectoren, waarvoor de urgentie de afgelopen periode opnieuw sterk zichtbaar is geworden.
- Het kabinet zal bij de verdere uitwerking en implementatie van het Techsoevereiniteitspakket en de CAII in dit geval aansluiting zoeken bij initiatieven vanuit het Nederlandse en Europese technologie-ecosysteem, waaronder de European Tech Creators Coalition (TTC). De TTC kan bijdragen aan een meer holistische benadering van de Europese technologiewaardeketen en een rol spelen bij de identificatie, prioritering en ondersteuning van projecten binnen onder meer CAII en de CADA.
- Het fiche is positief over de herziene opzet van de Chips for Europe Initiative 2.0, de introductie van het instrument van de Grand Challenges, de vraaggestuurde aanpak met vraagversnellers en vraagforum, strategische projecten en de versnelde vergunningsprocedures. Ook is het kabinet positief over het concept van Regions of Excellence.

Toelichting

Essentie voorstel

- Het voorstel bevat de drie herziene pijlers uit de Chips Act 1.0:
    - Chips for Europe Initiative 2.0: gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De Commissie wil de pilotlines uit Chips Act 1.0 sneller opschalen naar commerciële productie. Daarnaast introduceert het twee nieuwe instrumenten: (i) Grand Challenges voor grootschalige, sector overstijgende doorbraken, mede in samenhang met de nieuwe CADA, en (ii) Vraagversnellers, om de Europese vraag naar en toepassing van in Europa ontwikkelde en geproduceerde halfgeleiders te stimuleren.
    - Security of supply and demand: gericht op industriële capaciteit om de leveringszekerheid en weerbaarheid van de Europese halfgeleiderketen versterken. De definitie van first-of-a kind (FoaK) initiatieven uit de Chips Act 1.0 wordt verduidelijkt olm de gehele waardeketen te beslaan. Hierdoor valt de volledige halfgeleiderwaardeketen binnen deze definitie. Aan deze FoaK projecten zitten voordelen verbonden zoals vergunningsversnelling en stroomlijning en uitzonderingen op staatsteunkaders. Daarnaast worden Strategische Projecten geïntroduceerd, waarvoor mogelijk Europese financiering beschikbaar komt vanuit het aankomend MFK. Hiervoor sorteert de Commissie voor op

[1] Kamerstukken II 2025/26, 22 112, nr. 1195, Non-paper on the EU Tech Sovereignty Package

advanced manufacturing. Ook introduceert de Commissie een label voor Europese topregio's op het gebied van halfgeleiders (Regions of Excellence). Hiernaast wil de Europese Commissie publieke aanbestedingen in vitale en kritieke sectoren strategisch inzetten door, naast prijs, ook weerbaarheidscriteria te hanteren en verplichte ketenanalyses te introduceren om geopolitieke risico's in de halfgeleiderketen te beperken. Daarnaast creëert de Commissie de mogelijkheid om vergelijkbare verplichtingen op te leggen aan private partijen in risicogevoelige sectoren om stabielere en sterkere waardenketens in deze sectoren te stimuleren.

- Monitoring en crisisbeheersing: de Commissie introduceert een Business-to-Business Semiconductor Supply Chain Platform voor monitoring, stresstests en beter inzicht in ketenrisico's en behoudt de crisisinstrumenten als priority rated ordes en waardeketenmonitoring vanuit de eerste Chips Act.

Kritiek en aanvullende vragen

- Het fiche de focus op weerbaarheid en productiecapaciteit te eenzijdig defensief en mist het daarmee aandacht voor Europese onmisbaarheid en welvaart in het voorstel.
- Het fiche is daarnaast ook kritisch op een aantal onderdelen van het CAII voorstel:
  - Het fiche pleit voor expliciete opname van equipment design & prototyping in de first-of-a-kind-definitie (FoaK, die een uitzondering op de staatssteunkaders mogelijk maakt).
  - Het fiche heeft zorgen over de grote rol van de Commissie, de beperkte rol voor de lidstaten via het informele forum van de ESB, en het gebrek aan een transparante selectieprocedure voor Strategische Projecten en Grand Challenges. Dit is tevens opgenomen in de juridische paragraaf van het fiche
  - Het fiche is kritisch op de verplichtingen en governance van het voorstel met betrekking tot crisismechanismen, die nog nadere uitwerking behoeft in risicocriteria en drempelwaarden. Daarbij erkent het kabinet wel de noodzaak voor het opleggen van mitigerende maatregelen ter bevordering van stabielere waardenketens in kritieke en risicogevoelige sectoren.

Krachtenveld

- Met het TSP wil de Commissie een grotere regierol pakken over de gehele digitale waardeketen; deze aanpak wordt op hoofdlijnen verwelkomd door zowel grote als kleine lidstaten. Het Europees Parlement pleit voor verdergaande maatregelen.
- Een meerderheid van de lidstaten onderschrijft naar verwachting de doelstellingen van de CAII. Er zal verdeeldheid bestaan over de ruimte voor samenwerking met niet-Europese aanbieders en de selectie van de strategische projecten.